



Taiwan Polyimide

We know Polyimide

法說會報告資料

Kevin Chen/Janifer Huang/Paul S. C. Wu

Nov. 07, 2025

CONFIDENTIAL

免責聲明

本簡報係由達邁科技股份有限公司(以下簡稱本公司)提供，本簡報可能包含前瞻性陳述，當中涉及風險與不明朗因素包括陳述本身的不確定性、風險、假設或其他因素如：經營上的改變、競爭環境、經濟情勢、法規變化、科技發展與超出本公司管控等因素，皆可能導致本公司實際營運結果與上開前瞻性陳述有很大的差異。本公司不承擔因情勢變更而即時更新或修正相關內容之義務。

本簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證券或金融商品的邀約，邀約之引誘或建議。本公司已盡合理之注意，使本簡報於公開時無任何不真實或誤導。本公司及其各關係企業代表人或董事，均不對此使用或因他人引用本份簡報資料、或其它因簡報資料導致的任何損害負擔任何責任。

公司簡介

2025年Q1~Q3營運情形

公司發展策略 & 布局未來

問題與交流

公司簡介

報告者:陳岱村副總經理

Company Profile 簡介



Polyimide Film
Manufacturer

- Established: June, 2000
- Company capital: ~47M USD
- Plant sites: Hsinpu & Tongluo
- Employees: ~399
- IPO in TSE: October, 2011



2025年Q1~Q3營運情形

綜合損益表



單位：新台幣佰萬元

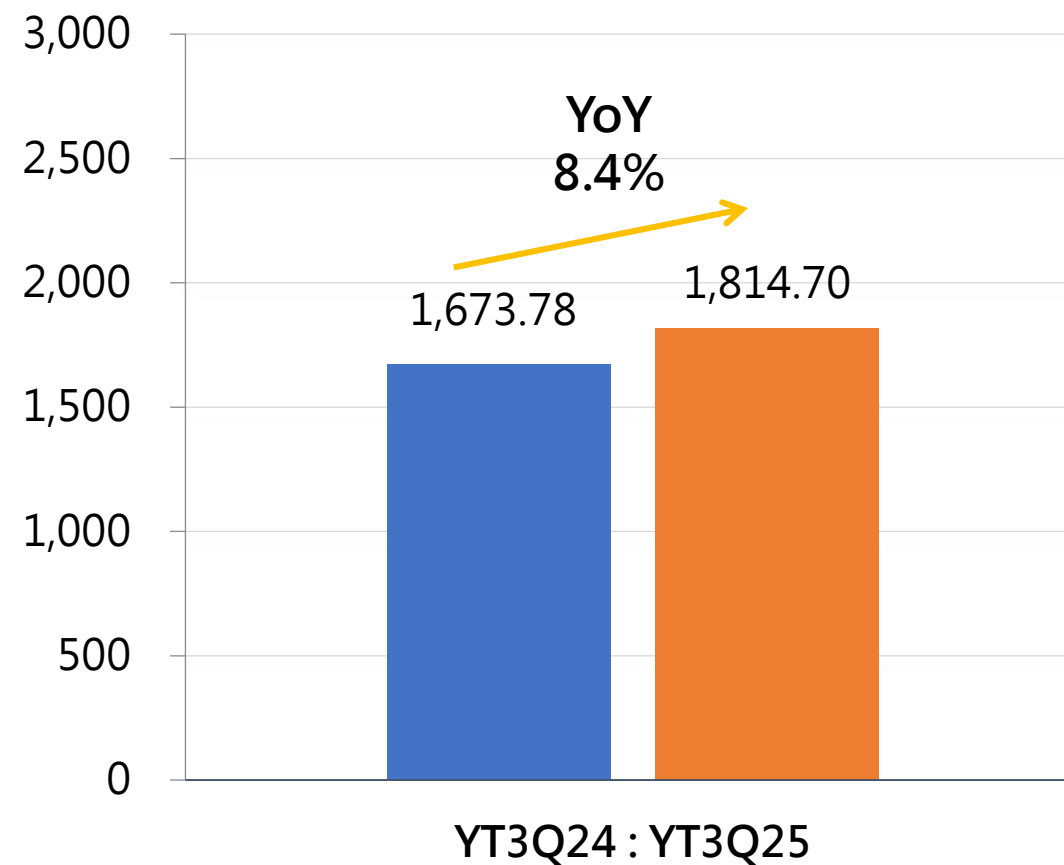
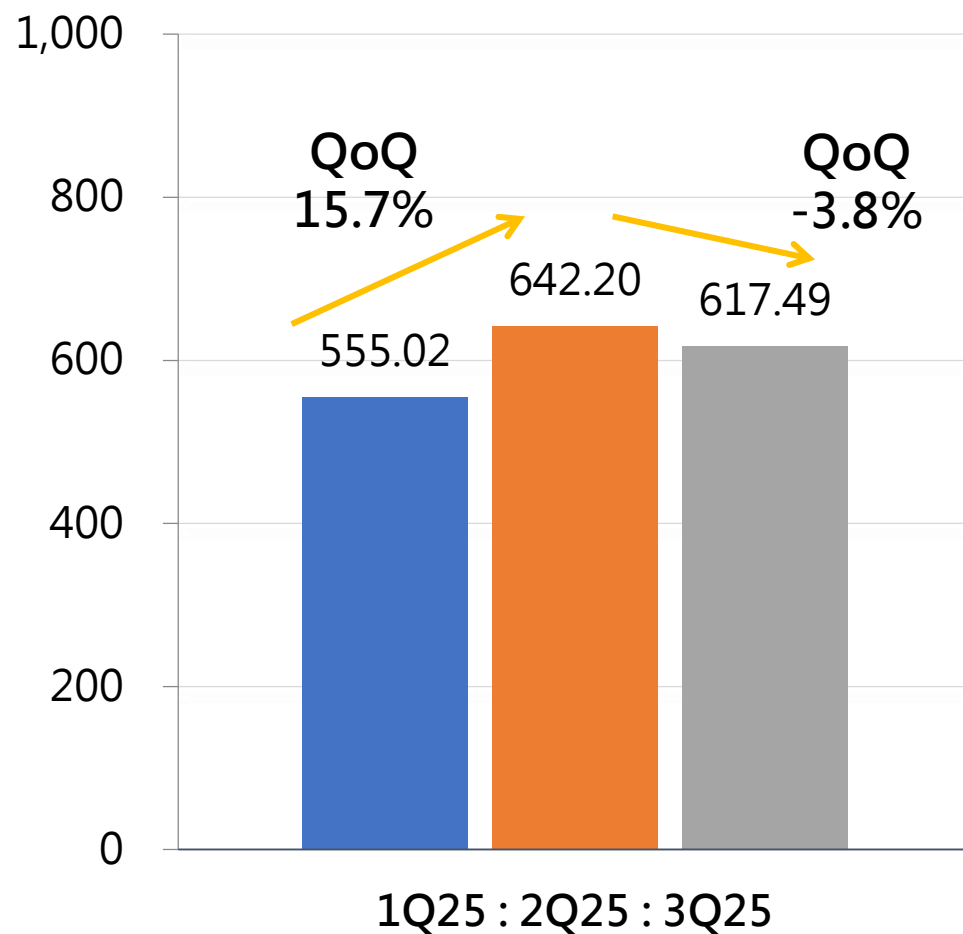
綜合損益表項目	3Q25	2Q25	1Q25	YT3Q25	YT3Q24	季變化	年變化
營業收入淨額	617.49	642.20	555.02	1,814.70	1,673.78	-3.8%	8.4%
營業毛利率	24.8%	28.9%	22.3%	25.5%	28.1%	-4.1ppts	-2.6ppts
營業費用	104.28	87.84	79.91	272.03	290.51	18.7%	-6.4%
營業利益	48.86	98.03	43.62	190.50	179.95	-50.2%	5.9%
營業淨利率	7.9%	15.3%	7.9%	10.5%	10.8%	-7.4ppts	-0.3ppts
營業外收入及支出	27.38	(78.50)	10.13	(40.97)	24.74	N/A	-265.6%
稅前淨利	76.24	19.53	53.75	149.53	204.69	290.4%	-27.0%
所得稅費用(利益)	15.39	(0.04)	14.41	29.78	2.13	N/A	1298.1%
合併本期淨利	60.85	19.57	39.34	119.75	202.56	210.9%	-40.9%
純益率	9.9%	3.0%	7.1%	6.6%	12.1%	6.9ppts	-5.5ppts
每股盈餘(新台幣元)	0.47	0.16	0.31	0.94	1.61	193.8%	-41.6%

*2025年第三季加權平均流通在外股數為137佰萬股

合併營業收入



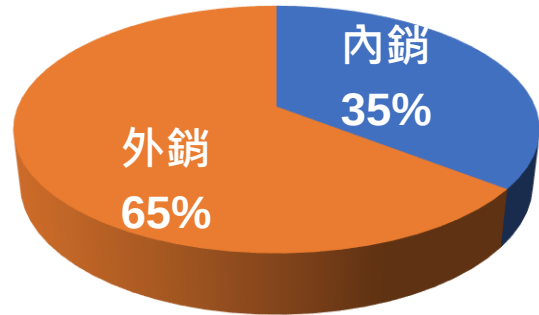
單位：新台幣佰萬元



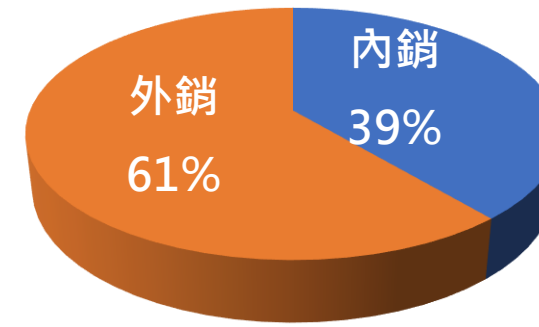
銷售市場



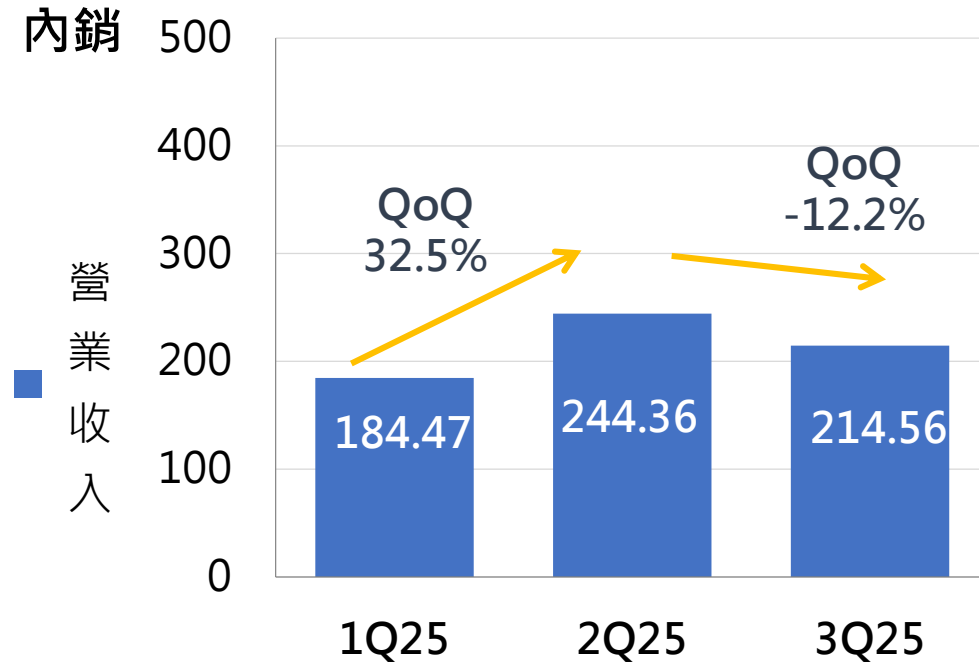
2025年Q1~Q3



2024年Q1~Q3

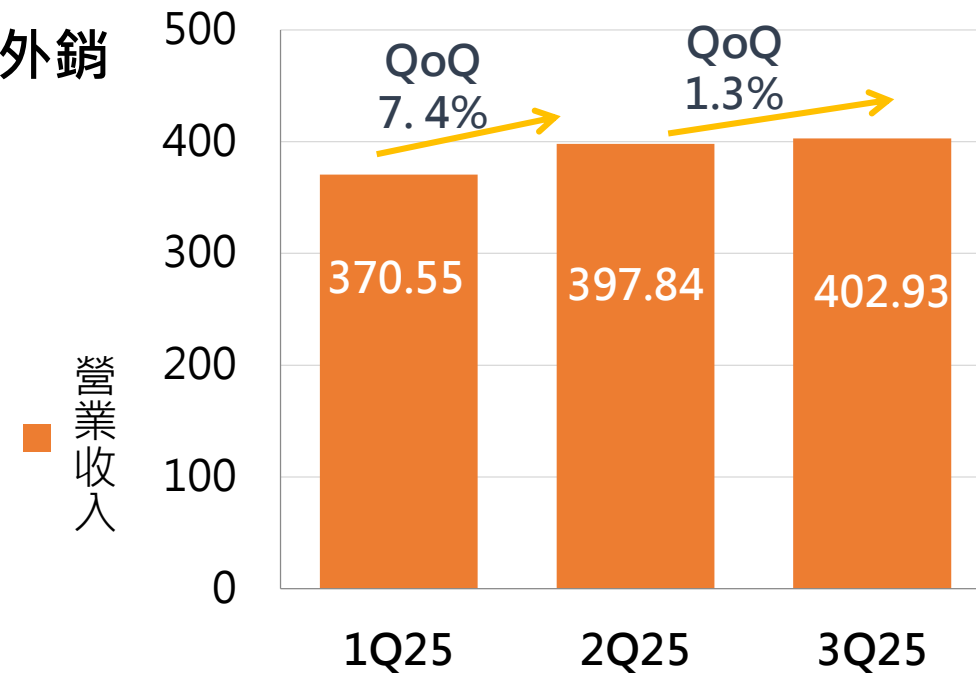


內銷



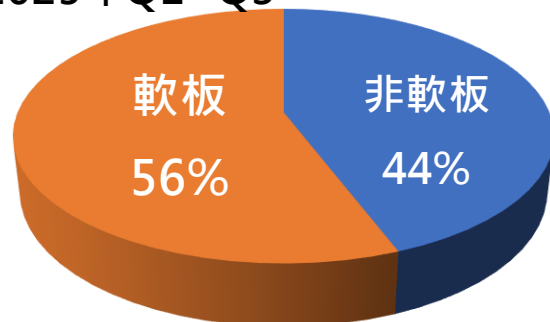
單位：新台幣百萬元

外銷

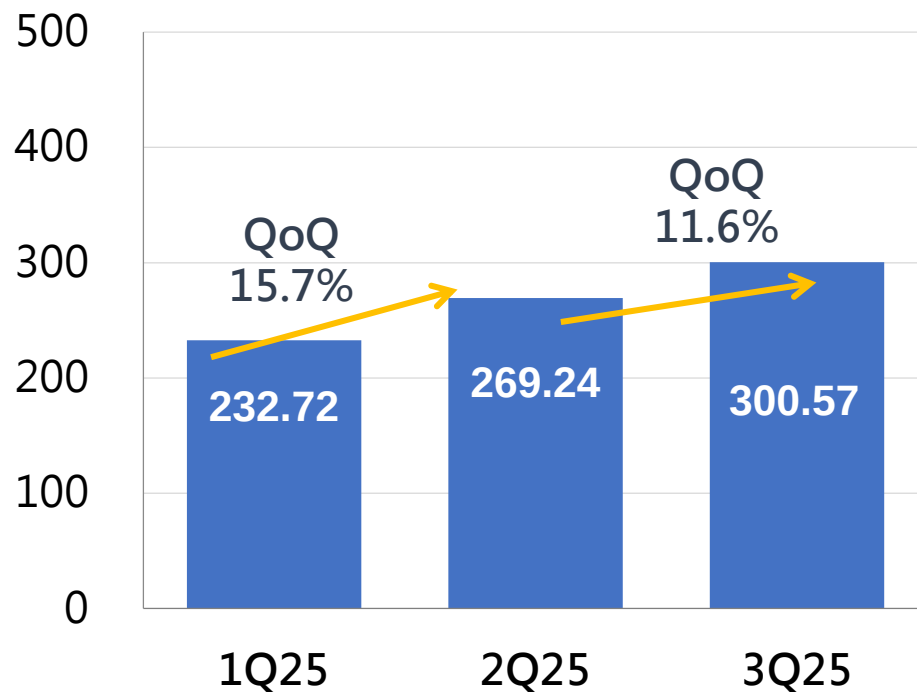


應用市場

2025年Q1~Q3

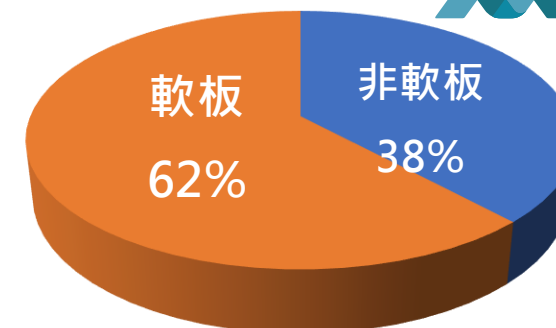


非軟板



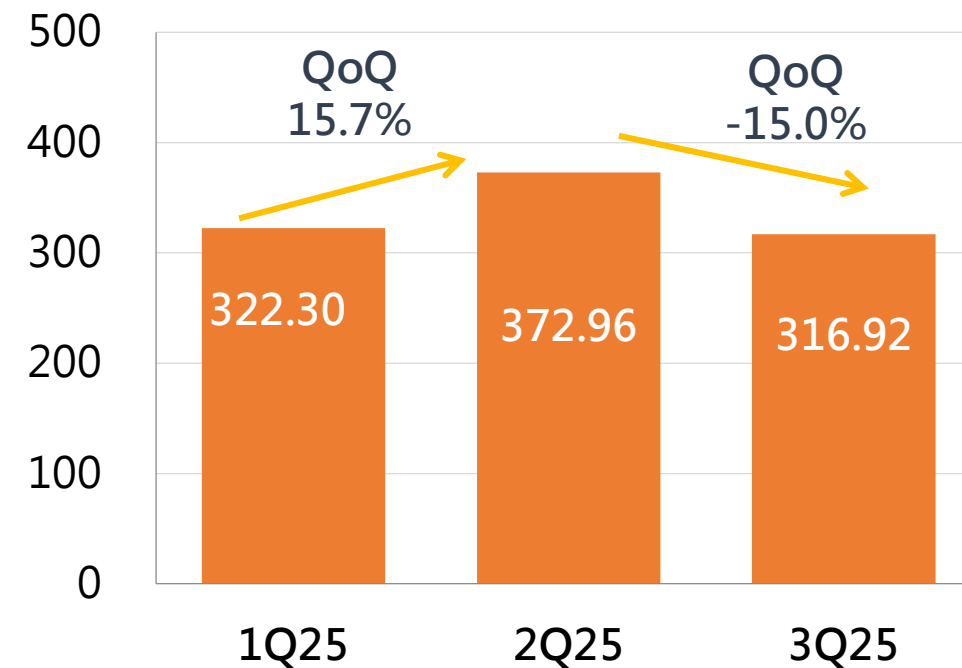
2024年Q1~Q3

TAIMIDE



單位：新台幣佰萬元

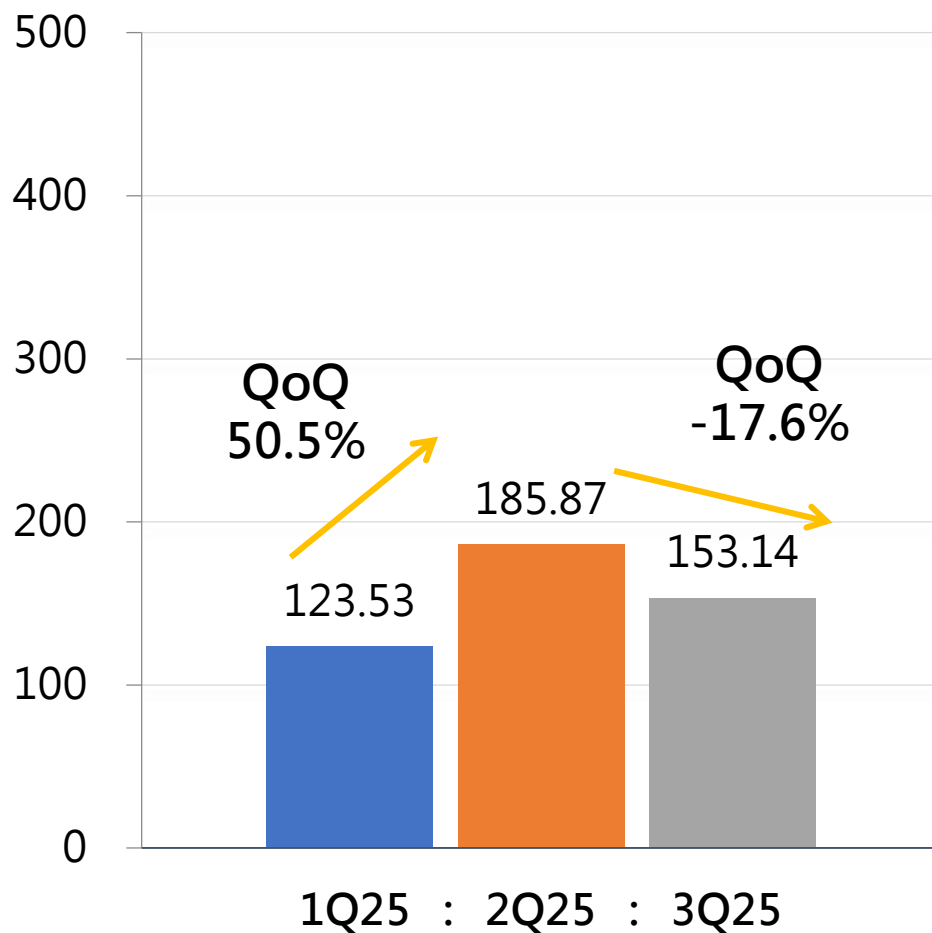
軟板



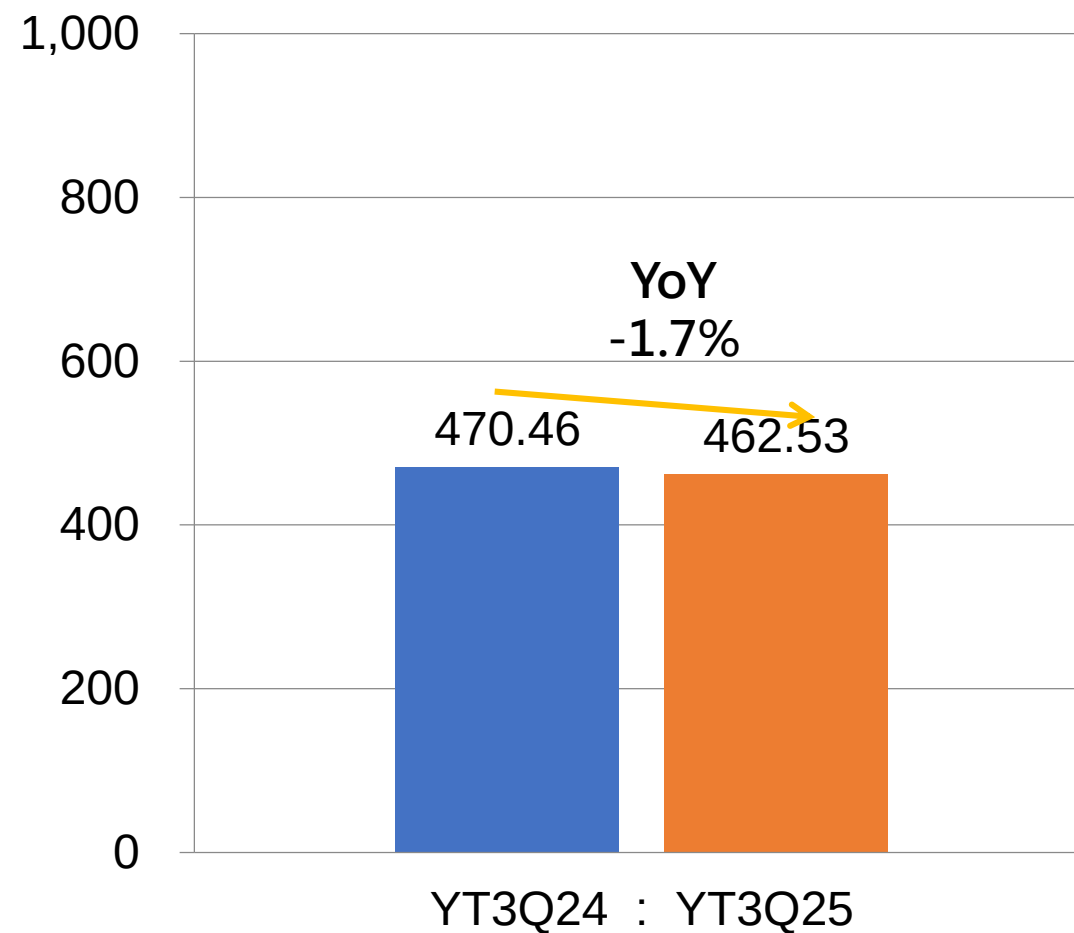
合併營業毛利及毛利率



單位：新台幣佰萬元



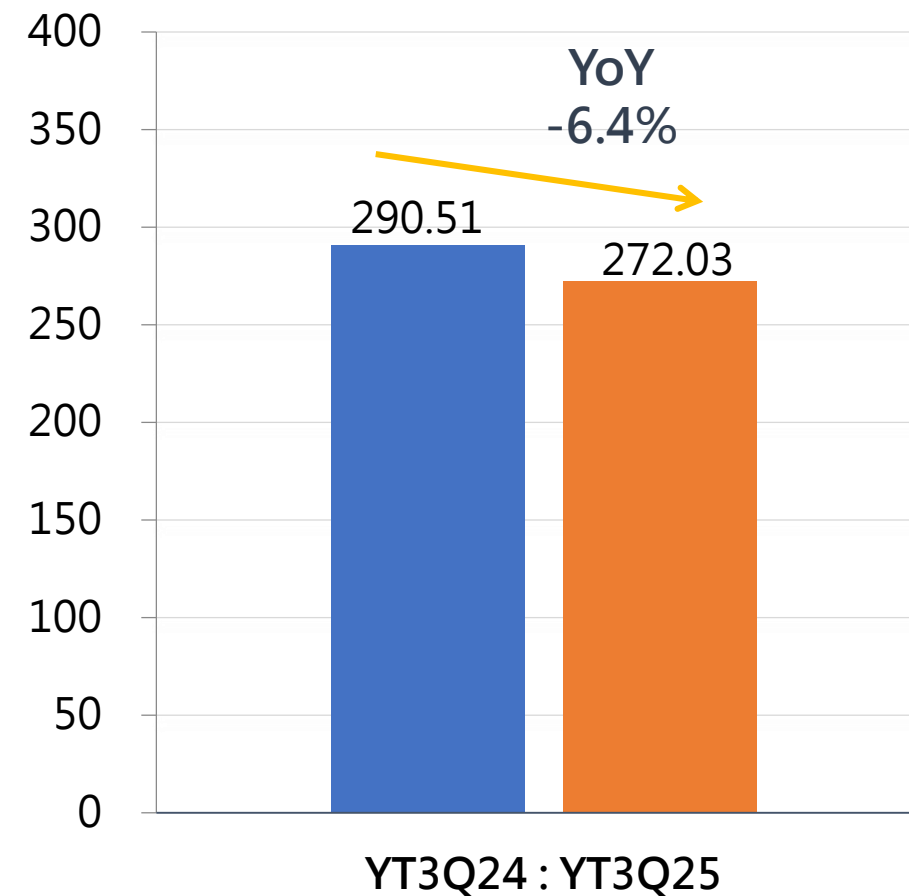
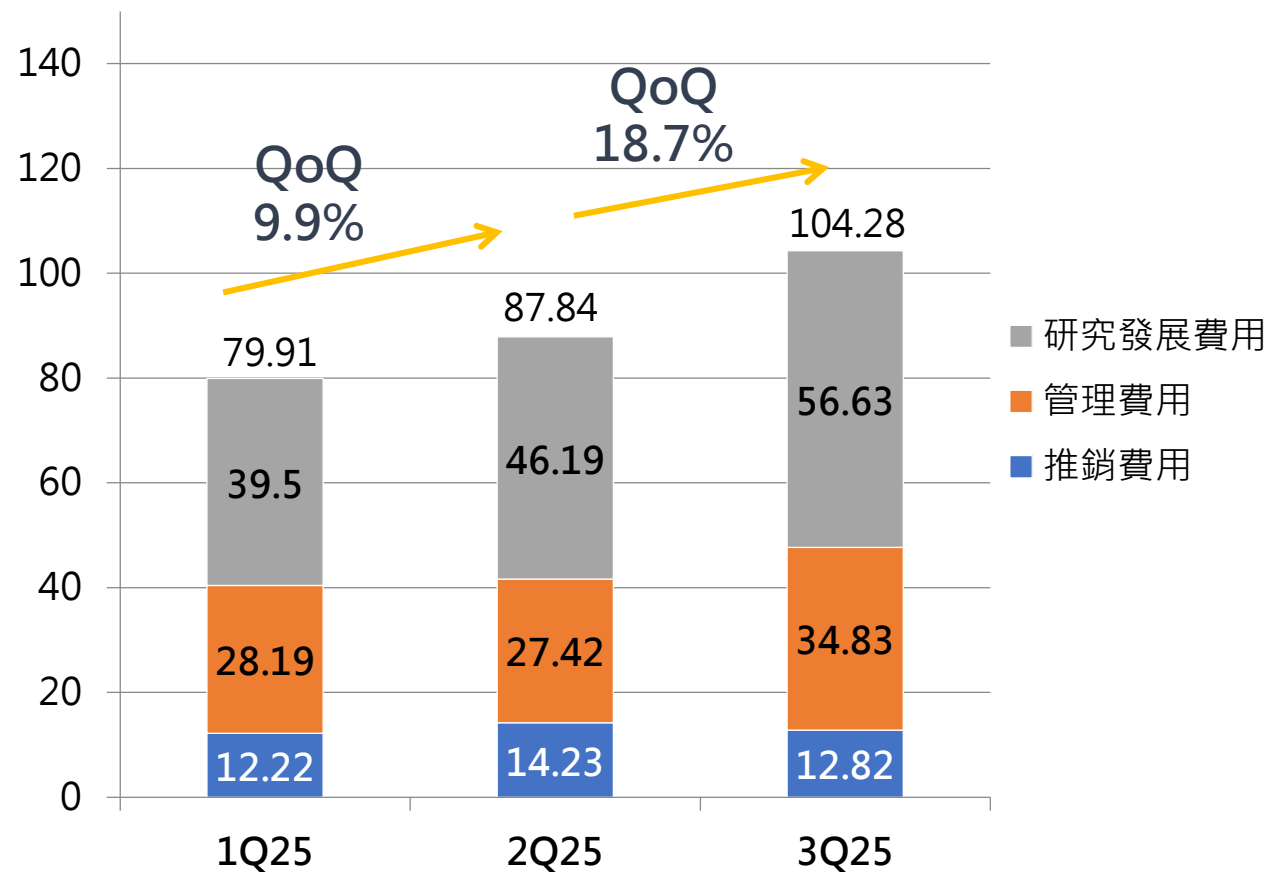
合併毛利益率： 22.3% 28.9% 24.8%



合併毛利益率： 28.1% 25.5%

合併營業費用

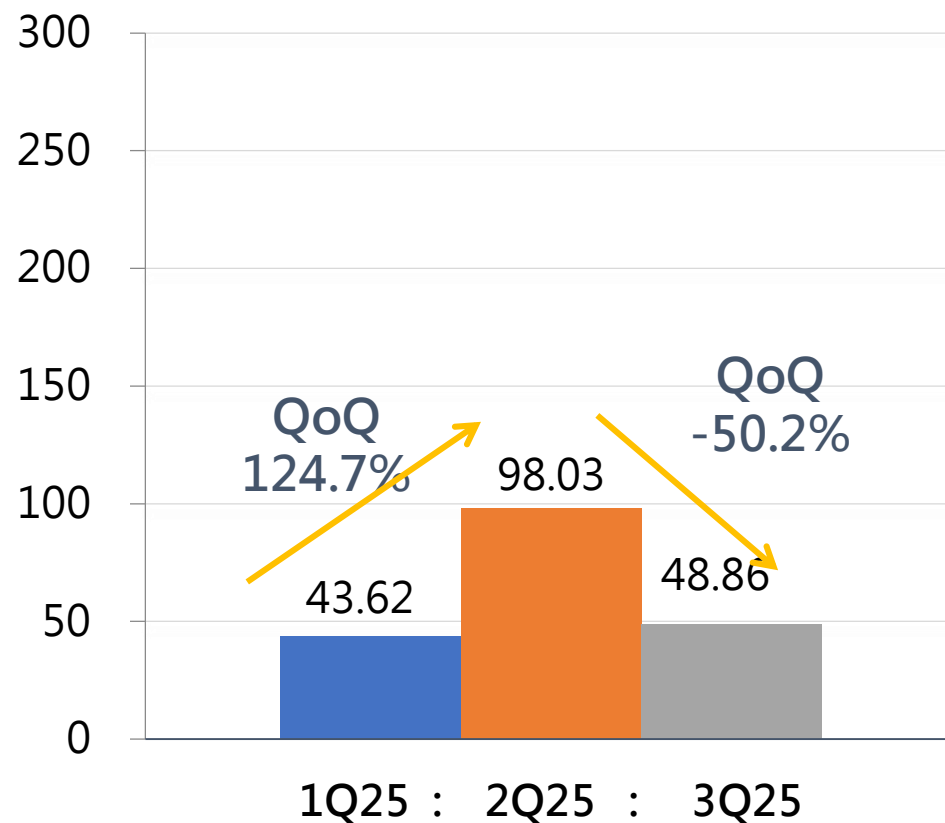
單位：新台幣佰萬元



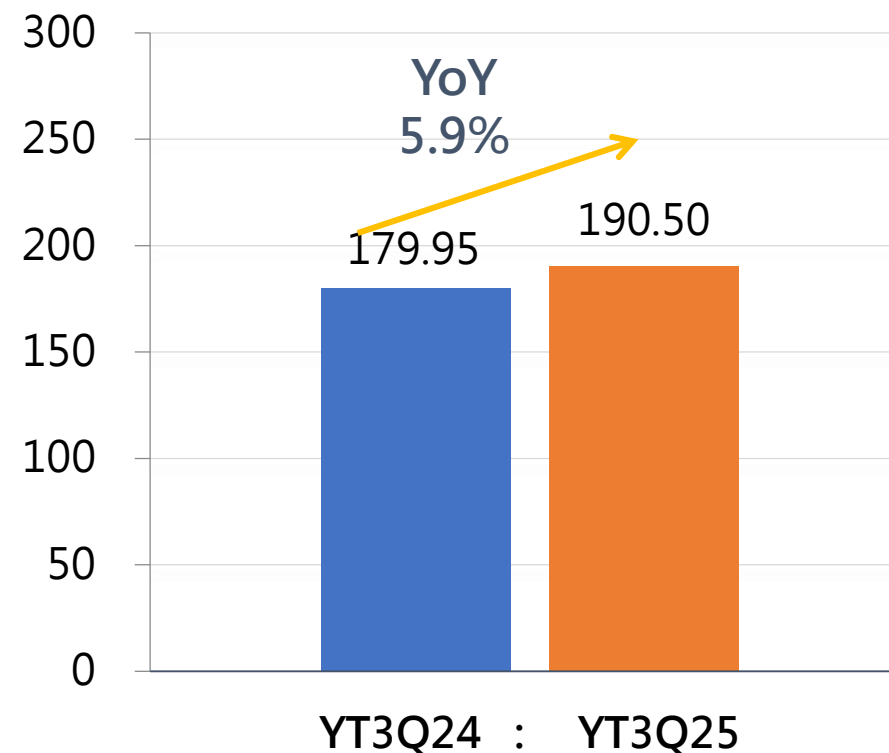
合併營業利益及利益率



單位：新台幣佰萬元



合併營業利益率：	7.9%	15.3%	7.9%
----------	------	-------	------

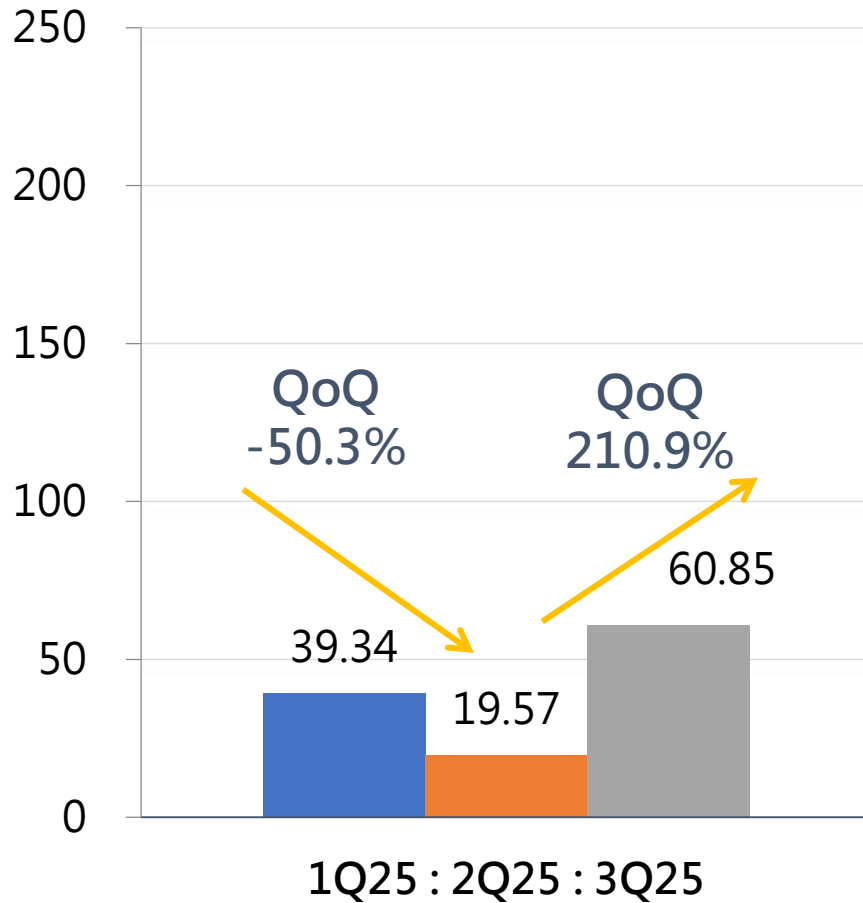


合併營業利益率：	10.8%	10.5%
----------	-------	-------

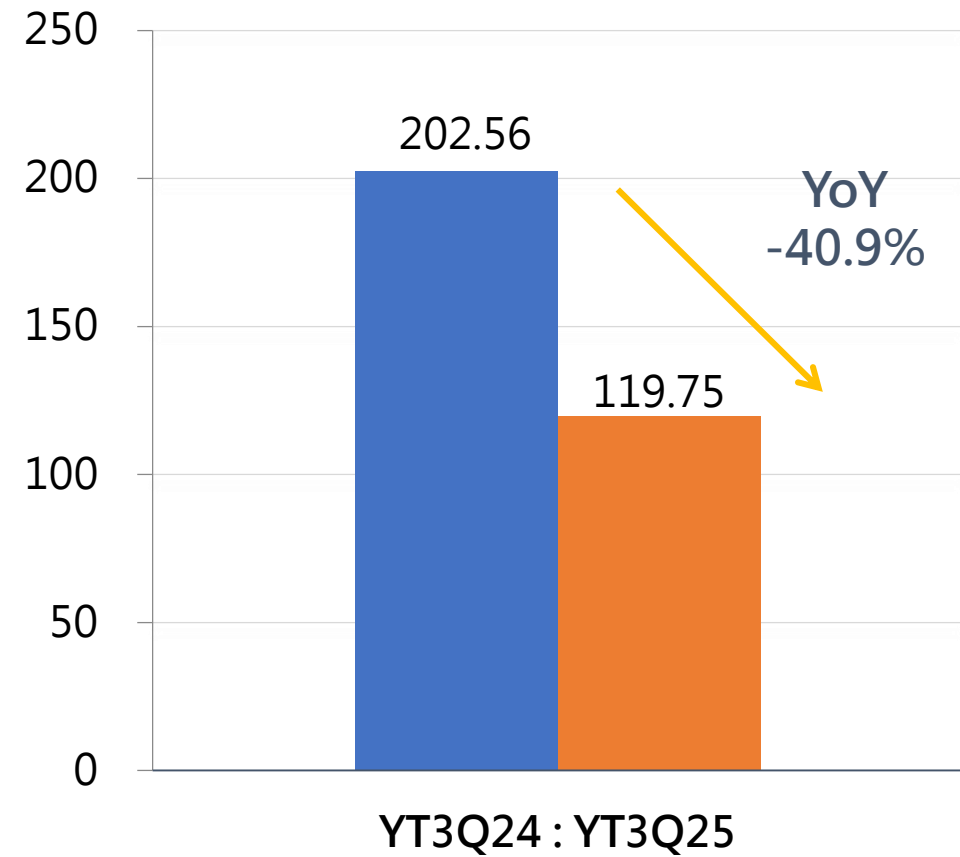
合併本期淨利、淨利益率及EPS



單位：新台幣佰萬元



淨利益率：	7.1%	3.0%	9.9%
EPS：	0.31	0.16	0.47



淨利益率：	12.1%	6.6%
EPS：	1.61	0.94

資產負債表及重要財務指標



資產負債表項目	3Q25		2Q25		1Q25		3Q24	
單位：新台幣佰萬元	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
現金及有價金融商品投資	666.90	13.2%	743.19	14.2%	408.73	8.4%	355.60	7.2%
應收帳款	724.79	14.4%	796.12	15.2%	759.96	15.6%	755.15	15.3%
存貨	315.18	6.2%	357.53	6.8%	403.88	8.3%	410.49	8.3%
不動產、廠房及設備	2,913.02	57.7%	2,969.90	56.6%	3,036.09	62.2%	3,124.33	63.3%
其他資產	428.26	8.5%	377.26	7.2%	271.31	5.5%	287.46	5.9%
資產總計	5,048.15	100.0%	5,244.00	100.0%	4,879.97	100.0%	4,933.03	100.0%
流動負債	856.50	17.0%	1,216.10	23.2%	868.25	17.8%	1,069.98	21.7%
長期計息負債	840.77	16.7%	739.20	14.1%	595.87	12.2%	741.53	15.0%
其他負債	118.00	2.3%	119.81	2.3%	125.53	2.6%	136.90	2.8%
負債總計	1,815.27	36.0%	2,075.11	39.6%	1,589.65	32.6%	1,948.41	39.5%
權益總計	3,232.88	64.0%	3,168.89	60.4%	3,290.32	67.4%	2,984.62	60.5%
重要財務指標								
平均銷貨日數	76.39		80.67		85.36		100.21	
流動比率(倍)	2.08		1.63		1.90		1.50	
資產生產力(倍)	0.81		0.80		0.79		0.70	

*2025年第三季加權平均流通在外股數為137佰萬股

**資產生產力=年化營業收入淨額/平均不動產、廠房及設備淨額

公司發展策略 & 布局未來

第一章

報告者:黃貞英總經理

ELECTRONICS SYSTEMS MARKET FORECAST

	\$Bn	2022	'23/'22	2023	'24/'23	2024	'25F/'24	2025F	 2029F	CAAGR '24-'29*
Computers	PC	269	-16.0%	226	3.5%	234	5.6%	247	284	3.9%
	Server/Data Storage	210	-4.8%	200	45.5%	291	36.1%	396	495	11.2%
	Other Computer	151	-2.5%	147	-2.8%	143	2.8%	147	175	4.1%
	Mobile Phones	392	-0.7%	390	6.8%	416	2.4%	426	535	5.2%
Communication	Wired Infrastructure	150	7.3%	161	-3.4%	156	5.7%	165	198	4.9%
	Wireless Infrastructure	86	-5.8%	81	-9.9%	73	4.8%	77	93	4.9%
Consumer	TV	94	-7.9%	87	0.7%	87	-2.6%	85	78	-2.3%
	AudioVideo/Personal	142	0.6%	143	1.0%	144	4.5%	151	174	3.8%
	Other Consumer	101	-1.6%	99	-1.1%	98	3.9%	102	118	3.8%
Automotive		252	11.8%	282	-4.8%	268	1.2%	272	342	5.0%
Industrial		290	5.9%	307	1.8%	312	4.7%	327	414	5.8%
Medical		131	5.1%	138	4.7%	144	5.3%	152	181	4.7%
Military/Aerospace		161	6.8%	172	8.7%	187	6.4%	199	251	6.1%
Total		\$2,428	0.1%	\$2,431	5.0%	\$2,554	7.4%	\$2,743	\$3,337	5.5%

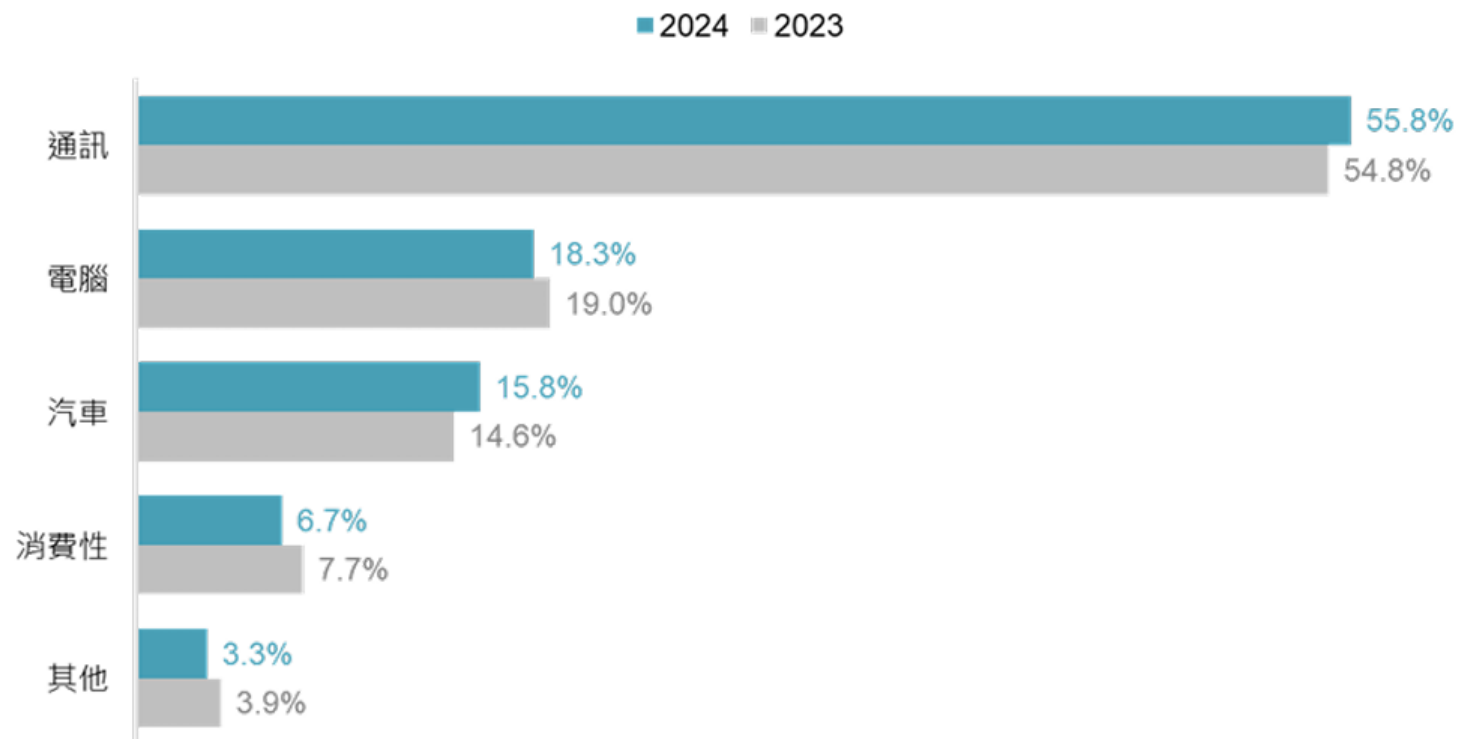
資料來源：TPCA PRISMAR PRESENTATION

全球軟板市場趨勢



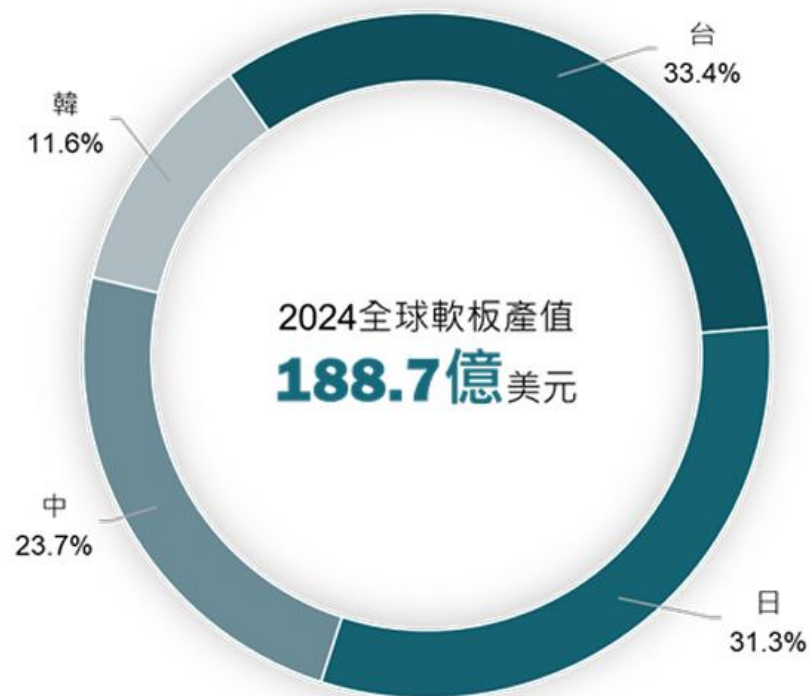
資料來源：TPCA & 工研院產科國際所

軟板主要應用分布



資料來源：TPCA & 工研院產科國際所

全球軟板市占率分布



資料來源：TPCA & 工研院產科國際所

2025年 溫和成長的一年

2026年 斜槓元年

目標

2025 年成就 / 現狀

2026 年策略重點

更薄

經過努力，可望
迎來2026下半年的
訂單

- 希望擴大使用
範圍

更厚/高性能

提高性能，已得
到客戶的認同

- 朝擴大市占或
自我替代努力
- 持續再提高導
熱性能

更霧

完成認證，等待
客戶放量

更多元

經過近2年的努力，
跨入了另一個領
域

- 希望有更多PI
品項及更多應
用場景可導入
客端

公司發展策略 & 布局未來

第二章

報告者:吳聲昌董事長

未來的經營環境

- 多變的、不可預測的國際局勢

- ① 地緣政治的瞬息萬變 (區域戰爭的持續、美中台經濟、國安、科技角力.....)
 - a. 貿易壁壘逐漸高築
 - b. 生產基地 2+1 布局規劃
- ② AI 人工智慧的深度進化、引領未來社會活動變化的不確定性

- 必須面對的全球暖化、氣候變遷議題

- ① 碳足跡的盤點、淨零碳排、碳中和、碳稅開徵帶來的企業經營衝擊

- 達邁思考的對應之道

用開放的心態，擴展各陣營、各產業合作，積極布局下一世代產業需求所需PI

雙十展翼、再創新局 (第六講)

A. 兩支硬翅膀的 布局

- a. 第一支翅膀: Fluomide® for 5G
- b. 第二支翅膀: OPI® for Foldable AMOLED

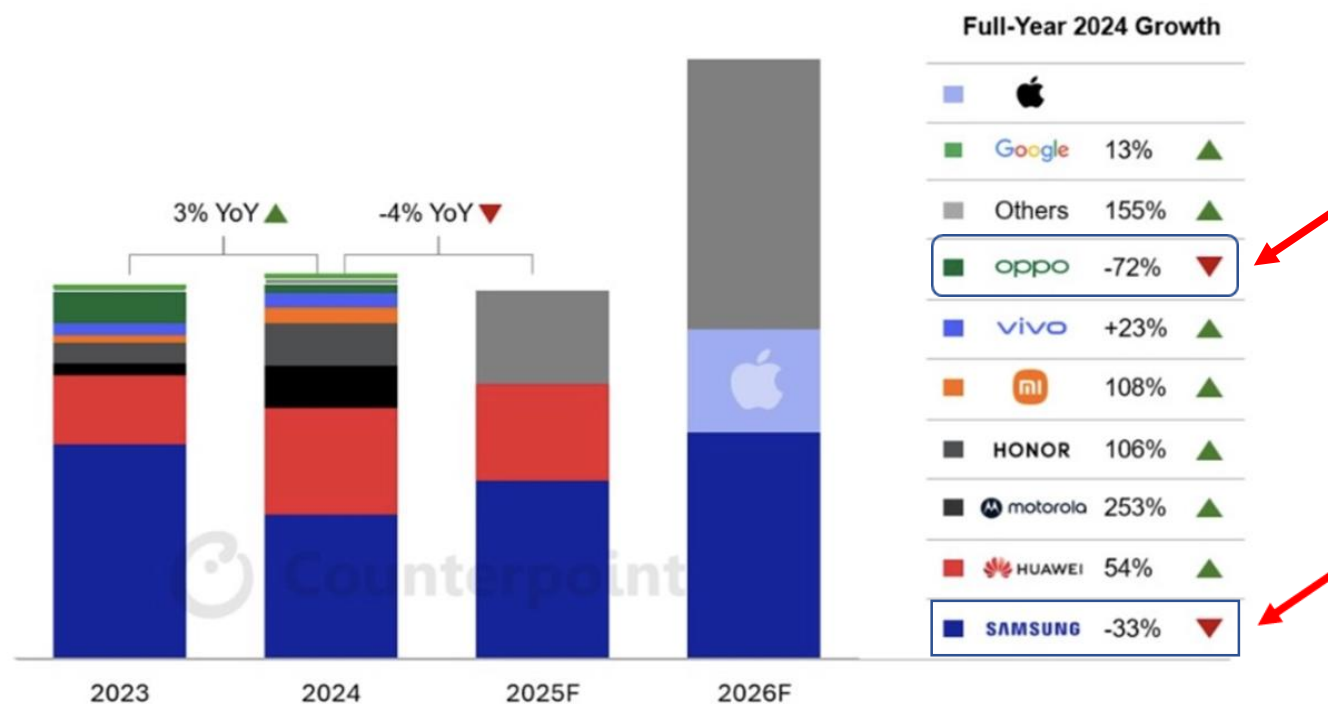
PFAS Free 危機就是轉機：從零開始的另外兩支硬翅膀

B. VCP 的發展 策略

達邁新格局: Not only PI film Manufacturer · but also a Value Chain Provider (VCP)

摺疊智慧型手機：UTG Vs. OPI

Global Foldable Smartphone Shipment Forecast



全球摺疊智慧型手機市場
 -2025 年迎首度衰退，
 -2026 年將強勁反彈
 -Mar. 2025

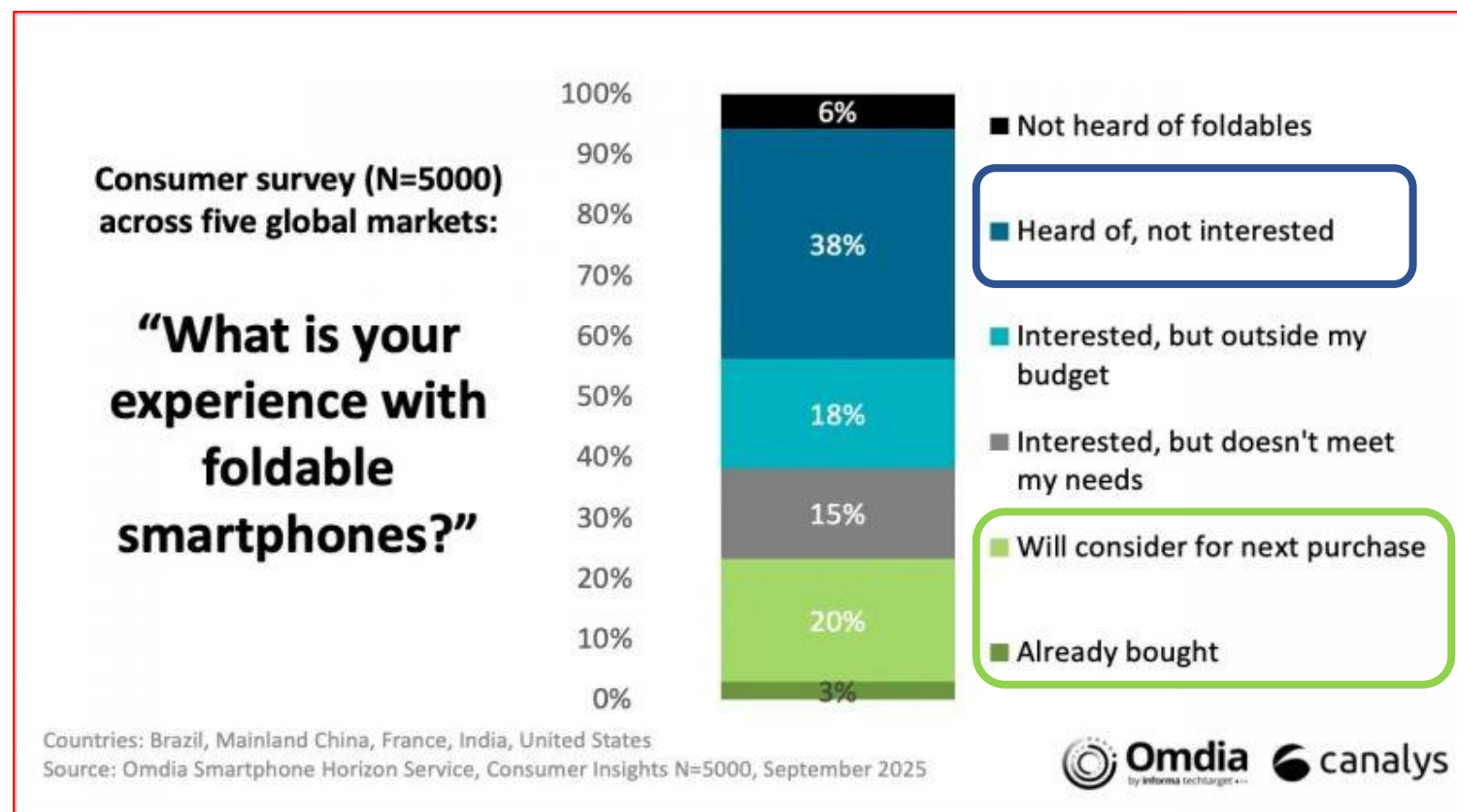
參考資料: <https://technews.tw/2025/03/31/2025-foldable-phone/>

蘋果摺疊智慧型手機：看好度調查

-Sep. 2025

- Omdia在巴西、中國大陸、法國、印度和美國對5000名受訪者調查
- 只有23%的受訪者表示他們已經購買了或正在考慮購買。
- 高達38%的受訪者表示他們不喜歡這種外形。這顯示蘋果公司面臨巨大的挑戰。
- 蘋果新款可折疊iPhone的需求群普遍冷淡

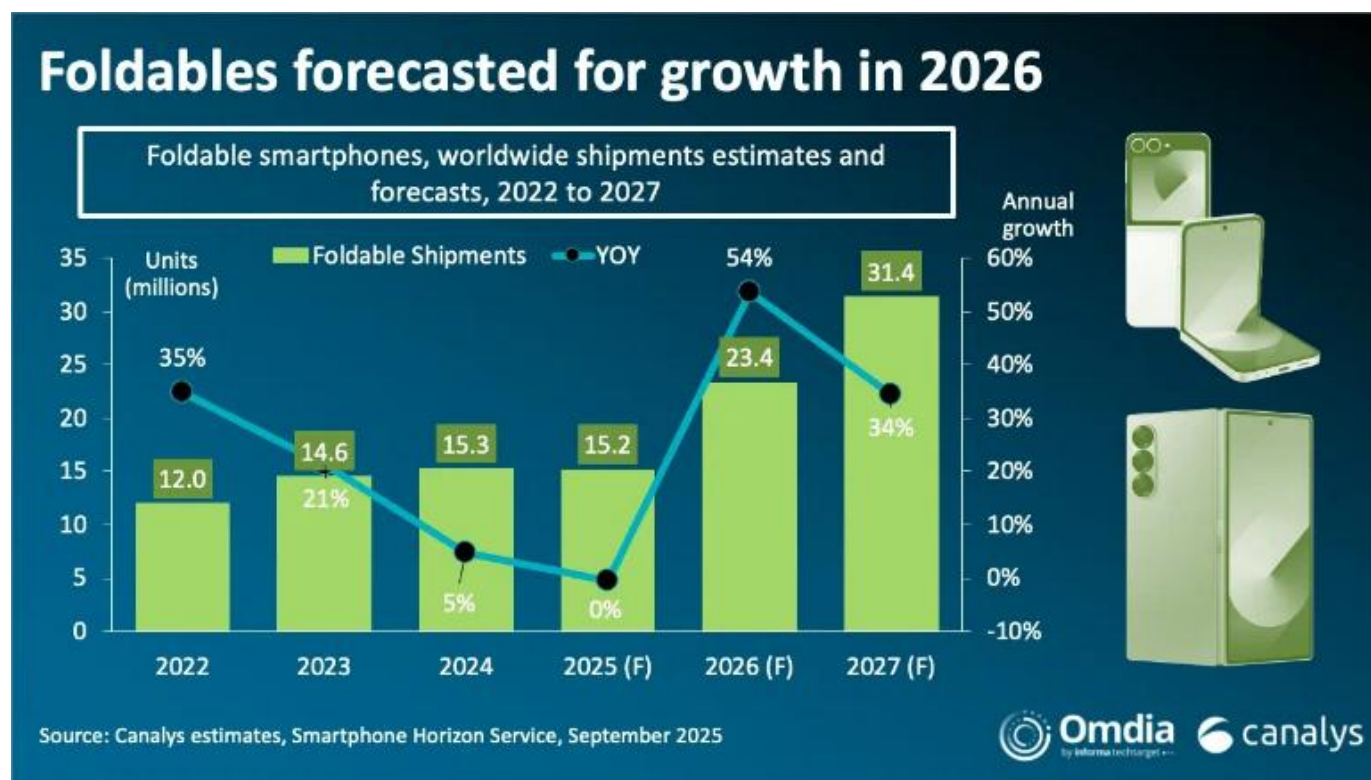
資料來源 :<https://www.xfastest.com/thread-305024-1-1.html>



蘋果摺疊智慧型手機：看好度調查 -Sep. 2025

- 當然 iPhone 製造商以在幾乎每個方面都完美無缺後才會推出產品而聞名。
- 或許正是因為這個因素，**Canalys**預測**2026年可折疊智慧型手機出貨量將大幅成長54%**。
- 這項預測能否成為現實，還是事後會完全被拋棄，很大程度取決於蘋果對新款可折疊iPhone的設計和行銷選擇。

資料來源 :<https://www.xfastest.com/thread-305024-1-1.html>



雙十展翼、再創新局 (第六講)

A. 兩支硬翅膀的 布局

- a. 第一支翅膀: Fluomide® for 5G
- b. 第二支翅膀: OPI® for Foldable AMOLED

PFAS Free 危機就是轉機：從零開始的另外兩支硬翅膀
比的是速度 (研發實力、效率、產品信價比.....)

B. VCP 的發展 策略

達邁新格局: Not only PI film Manufacturer , but also a Value Chain Provider (VCP)

Value Chain Provider (VCP) amazing projects

- μ LED Display application
- Camera VCM Module
- **AR Glasses**
- Medical Instrument application
- **Advanced IC Package**

終極功能的AR眼鏡-品牌商的進行式



難度最高的硬體工藝 ---

手機重量 240g vs. AR眼鏡目標 40g

現有市面材料與線路板技術難符需求

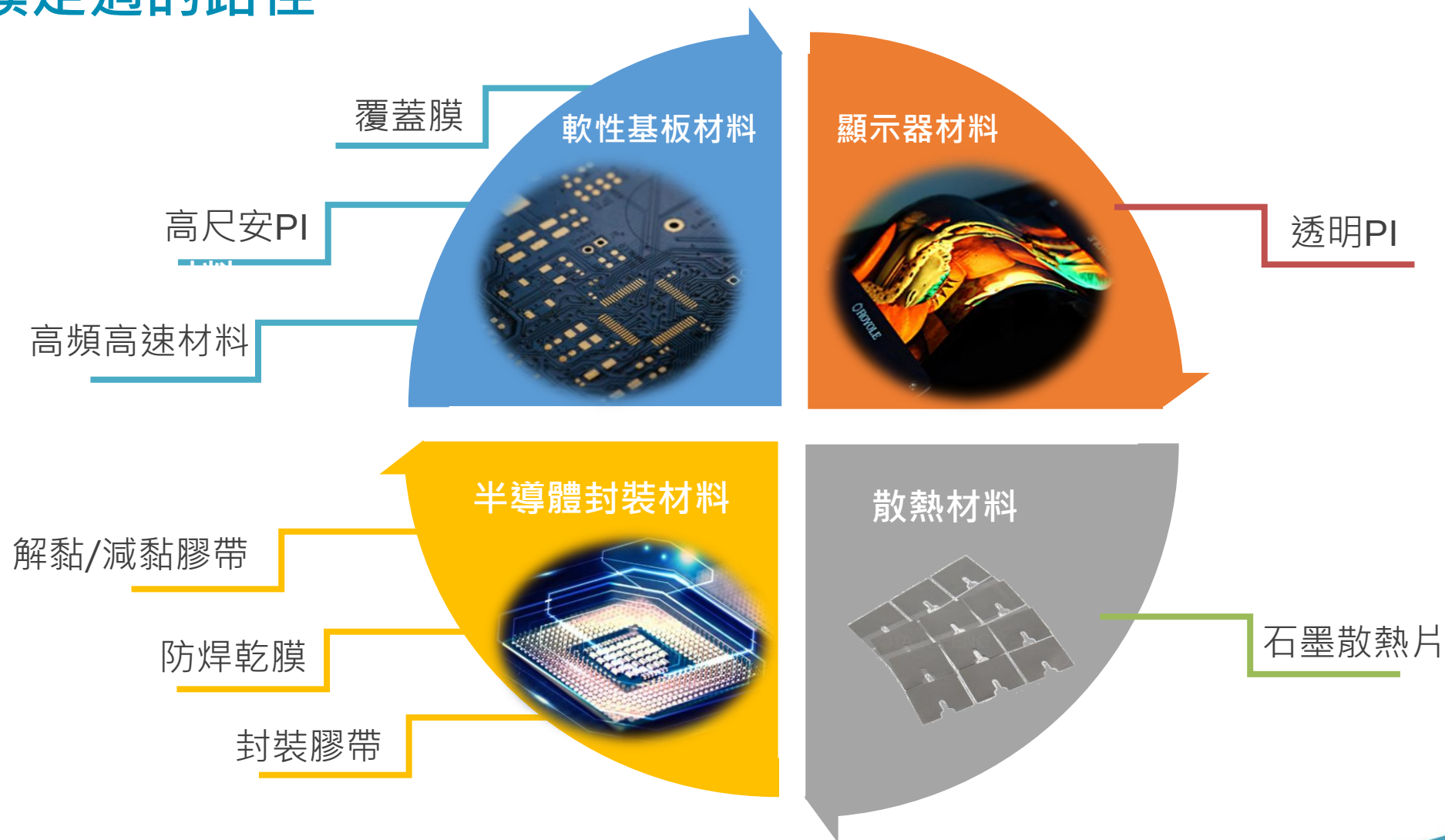
達邁與子公司 **PMR** 獨家專利技術導入

- ◆ 透明PI(Colorless PI)及金屬化技術
- ◆ 超薄 & 高尺安PI (Super Thin & Low CTE PI)及金屬化技術
- ◆ 超微細多層軟板半加成技術導入(mSAP Ultra Fine Line Multilayer FPC)

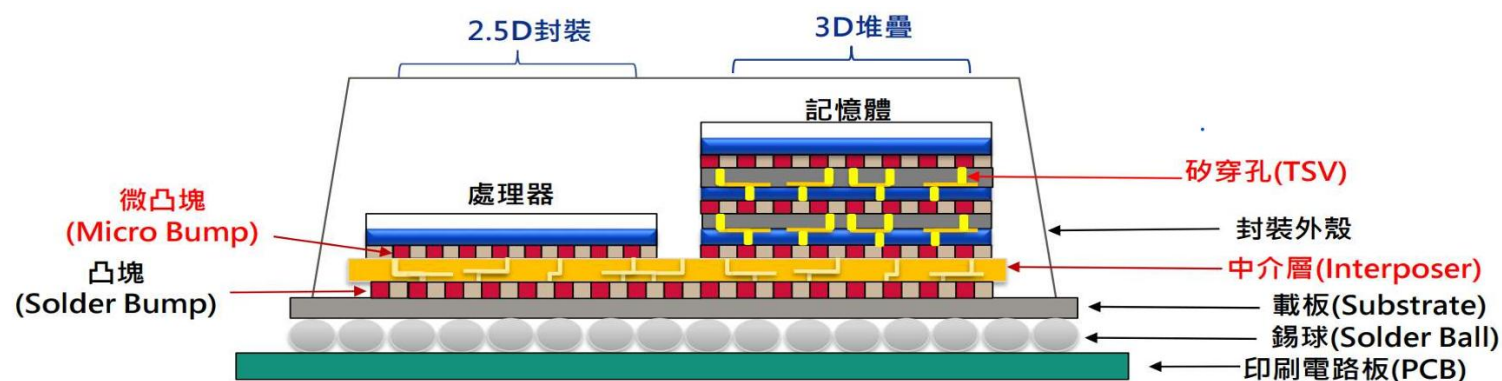
最嚴苛的要求、獨家技術支援

1. 自動眼球追蹤感測器
2. 近眼顯示器
3. 透明5G與WiFi天線
4. 超薄攝像鏡頭模組

達邁PI膜走過的路徑



Advanced IC Package



微凸塊 (Micro Bump)

- ◆晶片對晶片/載板黏附時，使用凸塊確保上下電極接合
- ◆隨著晶片封裝電極數量增加，間距縮小，凸塊尺寸必須縮小
- C4/1960s：150 μm (50 I/O)
- Cu Pillar(微凸塊)/2000s：
 - 150 μm (100 I/O)
 - 30 μm (1,000 I/O)
 - 10 μm (10,000 I/O)

中介層 (Interposer)

- ◆中介層可用於承載整合多個小晶片/晶粒，重新布線連接晶片與載板
- ◆中介層依不同應用需求，可選擇不同材料，一般可分為：
 - 矽中介層
 - 有機中介層(例如ABF、BT)
 - 玻璃中介層

矽穿孔 (Through-Silicon-Via)

- ◆TSV是3D堆疊核心關鍵
- ◆垂直堆疊晶片時，傳統邊緣布線已經無法滿足高密度互連的需求
- ◆TSV技術通過在矽晶片上鑽孔，並填充導電材料，實現了晶片正面與背面電極的直接連通

問題與交流



THE END